

Title (en)

Zn-Ni ALLOY PLATING SOLUTION BASED ON CHLORIDE BATH.

Title (de)

PLATTIERUNGSLÖSUNG FÜR EINE ZN-NI-LEGIERUNG AUF BASIS EINES CHLORIDBADES.

Title (fr)

SOLUTION DE PLACAGE EN ALLIAGE DE Zn-Ni A BASE D'UN BAIN DE CHLORURE.

Publication

**EP 0147463 A1 19850710 (EN)**

Application

**EP 83901938 A 19830617**

Priority

JP 8300196 W 19830617

Abstract (en)

A Zn-Ni alloy electroplating solution for obtaining Zn-Ni alloy-electroplated steel with excellent surface appearance, which contains ZnCl<sub>2</sub> and NiCl<sub>2</sub> as major components. In the solution, the percentage molar concentration, x(%), of Ni<sub>2+</sub>/Ni<sub>2+</sub> + Zn<sub>2+</sub> and the concentration of chloride (at least one chloride selected from the group consisting of AlCl<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>AlCl<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>Cl, KCl, NaCl, CaCl<sub>2</sub>, BaCl<sub>2</sub>, and MgCl<sub>2</sub>), y (mol/liter), are kept within the following ranges: - 0.2 x + 15.0 >/= y >/= - 0.2 + 9.0 7.0 >/= y >/= 0.2 60 >/= y >/= 10!

Abstract (fr)

Solution de dépôt électrolytique en alliage de Zn-Ni permettant d'obtenir de l'acier à revêtement électrolytique en alliage de Zn-Ni présentant un excellent aspect de surface, contenant comme composants principaux du ZnCl<sub>2</sub> et du NiCl<sub>2</sub>. Dans la solution, le pourcentage de la concentration molaire, x (%), de Ni<sub>2+</sub>/Ni<sub>2+</sub> + Zn<sub>2+</sub> et la concentration du chlorure (au moins un chlorure sélectionné dans le groupe se composant de AlCl<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>AlCl<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>Cl, KCl, NaCl, CaCl<sub>2</sub>, BaCl<sub>2</sub> et MgCl<sub>2</sub>), y (mol/litre), sont maintenus entre les limites suivantes:

IPC 1-7

**C25D 3/56**

IPC 8 full level

**B62D 5/08** (2006.01); **C25D 3/56** (2006.01)

CPC (source: EP)

**C25D 3/565** (2013.01)

Cited by

EP0162322A3; GB2321647A; US5985124A; GB2321647B; EP1914420B1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB

DOCDB simple family (publication)

**WO 8500045 A1 19850103**; EP 0147463 A1 19850710; EP 0147463 A4 19860415; JP H0534191 B2 19930521; JP S60501896 A 19851107

DOCDB simple family (application)

**JP 8300196 W 19830617**; EP 83901938 A 19830617; JP 50182884 A 19840504